



# 勤凱科技股份有限公司 2026/Q2

- ▶ 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。
- ▶ 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- ▶ 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



- ▶ 公司設立：2007年06月08日
- ▶ 資 本 額：NT\$ 3.22億
- ▶ 主要產品：先進封裝接著、散熱材料及  
陶瓷元件導電材料設計製造及銷售
- ▶ 公司地址：

高雄市大發工業區大有三街32號

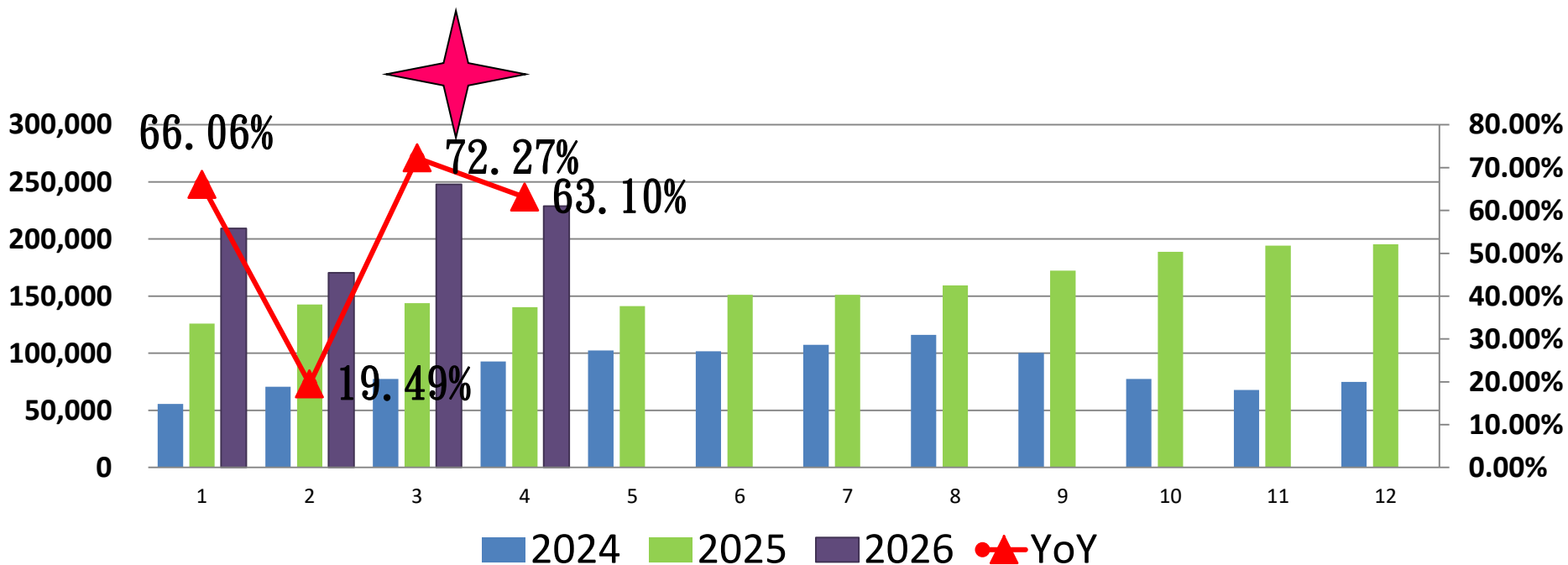
## 2025年《天下》兩千大營運績效50強

排名	公司名稱	'22年~'24年 營收成長率 (%)		'22年~'24年 稅後純益成長 率 (%)		2024年 股東權益報 酬率 (%)		2024年 營收成長 率 (%)		2024年 稅後純益成 長率 (%)		'22年~'24年 稅後純益總和 (億元)		總分	主要產品
		得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分						
1	濟南大自然新材料	91.85	20	158.27	19	50.84	20	42.51	19	61.09	16	147.64	19	113	香菸濾嘴用醋酸纖維絲束
2	華城電機	61.45	19	126.15	19	48.85	20	45.35	19	66.32	17	77.01	18	112	配電及電力變壓器等設備
3	名軒開發	109.63	20	101.97	18	30.75	19	68.14	19	52.47	16	49.94	17	109	住宅或商業大樓興建、租售
4	世芯電子	94.59	20	87.48	18	16.33	11	70.49	19	93.86	19	116.05	19	106	特殊應用積體電路設計製造
4	富宇地產	336.52	20	702.84	20	27.95	18	84.33	20	168.56	20	9.84	8	106	住宅或商業大樓興建、租售
6	台光電子材料	29.02	18	37.41	13	27.29	18	55.89	19	74.53	18	201.39	19	105	銅箔基板、黏合片等
6	新潤興業	91.29	20	72.32	17	25.10	17	149.25	20	117.71	19	17.44	12	105	住宅及大樓興建、租售
8	昇益開發	145.76	20	152.32	19	33.16	19	124.26	20	130.12	19	6.08	6	103	住宅及大樓興建、租售
8	皇普建設	75.59	20	133.62	19	18.29	12	188.16	20	436.78	20	17.79	12	103	住宅或商業大樓興建、租售
40	潤德室內裝修設計工程	37.34	18	47.47	15	25.28	17	31.73	17	51.35	15	4.75	4	86	設計與裝修工程
43	中台資源科技	43.14	19	50.74	15	14.95	9	34.98	18	60.39	16	8.44	8	85	廢棄物資源化處理
43	勤創科技	26.80	17	43.71	14	20.54	14	42.78	19	62.39	17	3.99	4	85	被動元件導電漿
45	力麗科技	52.30	19	29.38	11	22.34	15	99.78	20	35.88	14	5.39	5	84	IoT應用平台暨解決方案
46	肯微科技	24.02	16	36.52	13	9.89	5	32.04	18	78.57	18	21.49	13	83	伺服器電源供應器
46	信鼎技術服務	12.82	11	26.79	10	43.13	20	17.52	14	52.95	16	16.50	12	83	廢棄物資源化處理



2025年營運績效50強調查方法：將過去3年（2022~2024）每年營收、獲利皆持續成長的製造業與服務業，依長期成長、單年表現及企業規模等6項指標評估企業的營運績效。符合上述條件的企業，分別在每項指標中，依數值高低分成20等份，再依據相對位置給予1到20分。最後，將6項指標的得分加總，以總分排名。名次相同者，依公司名稱筆劃排序。

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Accumulate d
2021	134,517	140,857	146,066	154,568	155,720	162,519	166,611	165,828	162,539	131,852	112,998	101,094	1,735,167
2022	100,068	80,781	102,422	103,193	100,299	100,052	78,029	54,894	45,927	47,703	53,678	61,045	928,090
2023	55,712	70,767	77,474	92,910	102,508	101,741	107,330	116,087	100,286	77,414	67,862	74,912	1,045,002
2024	89,533	75,599	100,786	106,535	140,287	121,125	126,057	135,482	169,400	168,439	142,406	116,230	1,491,879
2025	126,050	142,604	143,812	140,320	141,377	151,040	151,219	159,285	172,303	188,815	194,189	195,386	1,906,400
2026	209,318	170,398	247,746	228,860									856,322
YoY	66.06%	19.49%	72.27%	63.10%									
MoM	7.13%	-18.59%	45.39%	-7.62%									



NT\$ 千元	2022	2023	2024	2025	2026. Q1	YoY	2025. Q1
營業收入	928,090	1,045,002	1,491,879	1,906,400	627,462	52%	412,467
營業毛利	194,267	224,069	326,055	410,118	123,851	29%	95,735
毛利率(%)	21%	21%	22%	22%	20%	-13%	23%
營業費用	(89,559)	(95,247)	(104,018)	(121,941)	(34,682)	22%	(28,497)
營業費用率(%)	9%	9%	9%	6%	6%	-14%	7%
營業淨利	104,708	128,822	222,037	288,177	89,169	33%	67,238
營業淨利率(%)	12%	12%	15%	16%	14%	-13%	16%
營業外收支淨額	11,709	14,345	15,758	(9,720)	9,965	35%	7,404
稅前淨利	116,417	143,167	237,795	278,457	99,134	33%	74,642
所得稅費用	(24,059)	(26,443)	(48,028)	(55,530)	(18,448)	32%	(13,965)
本期淨利	92,358	116,724	189,767	222,927	80,686	33%	60,677
淨利率(%)	10%	11%	13%	12%	13%	-13%	15%
每股盈餘(元)	<b>3.08</b>	<b>3.9</b>	<b>6.3</b>	<b>7.05</b>	<b>2.55</b>	<b>33%</b>	<b>1.92</b>
					5,258		
折舊費用	24,873	23,682	23,271	22,590	5,258		5,553
資本支出	12,419	13,020	12,489	9,427	937		2,446

年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025
每股盈餘	4.74	6.7	3.08	3.9	6.3	7.05
現金股利	3.2	4.5	2.2	2.7	3.7	4.5
股票股利	-	-	-	-	0.5	0.2
配發股利 合計	3.2	4.5	2.2	2.7	4.2	4.7
配息率	67.51%	67.16%	71.43%	69.23%	66.67%	66.67%

**連續13年配發股利！**

**合計配發31.4875元**

**(現金股利 25.12元+股票股利 6.3675元)**

## 被動元件

電容、電感、電阻

- 銀漿、銀鈮漿、銅漿、鎳漿

## 新材料

- AI

## IC\LED封裝

- 銀漿

## 觸控面板

電容式、電阻式

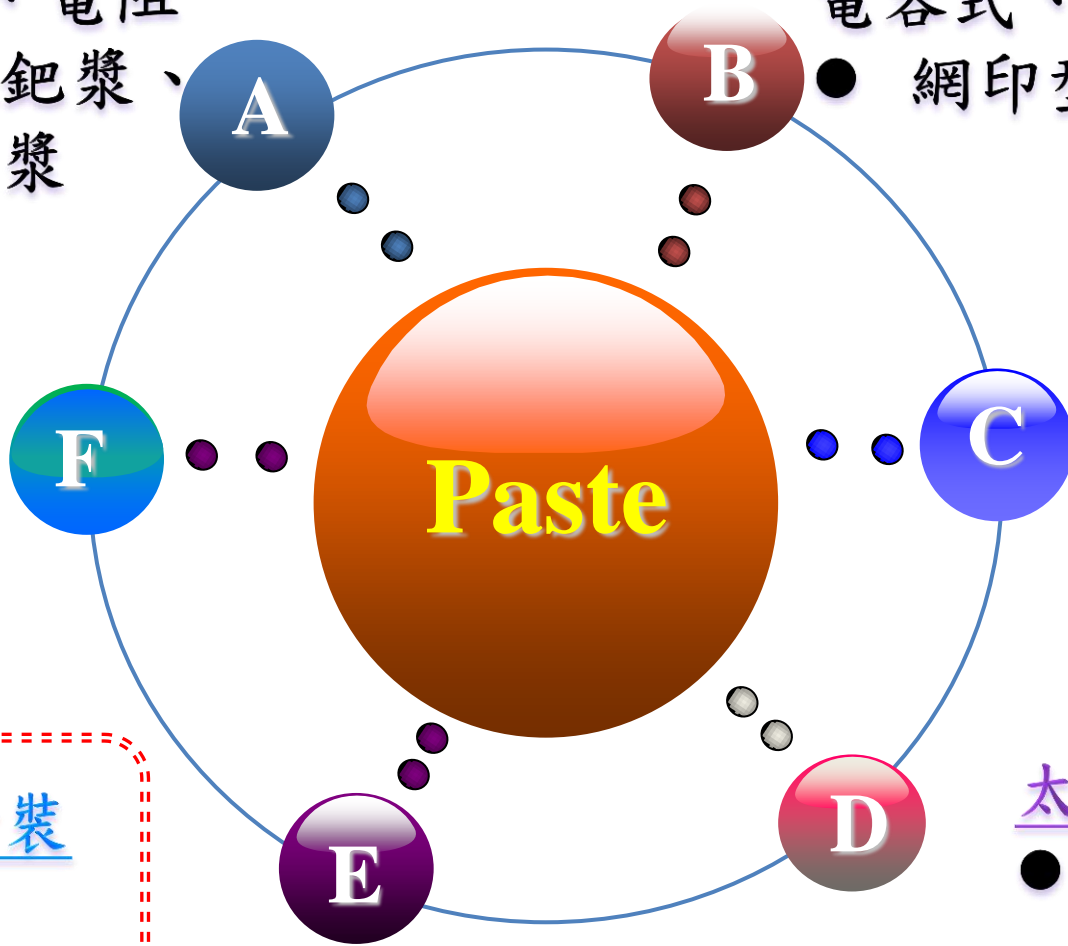
- 網印型、雷射型銀漿

## 薄膜開關

- 銀漿

## 太陽能

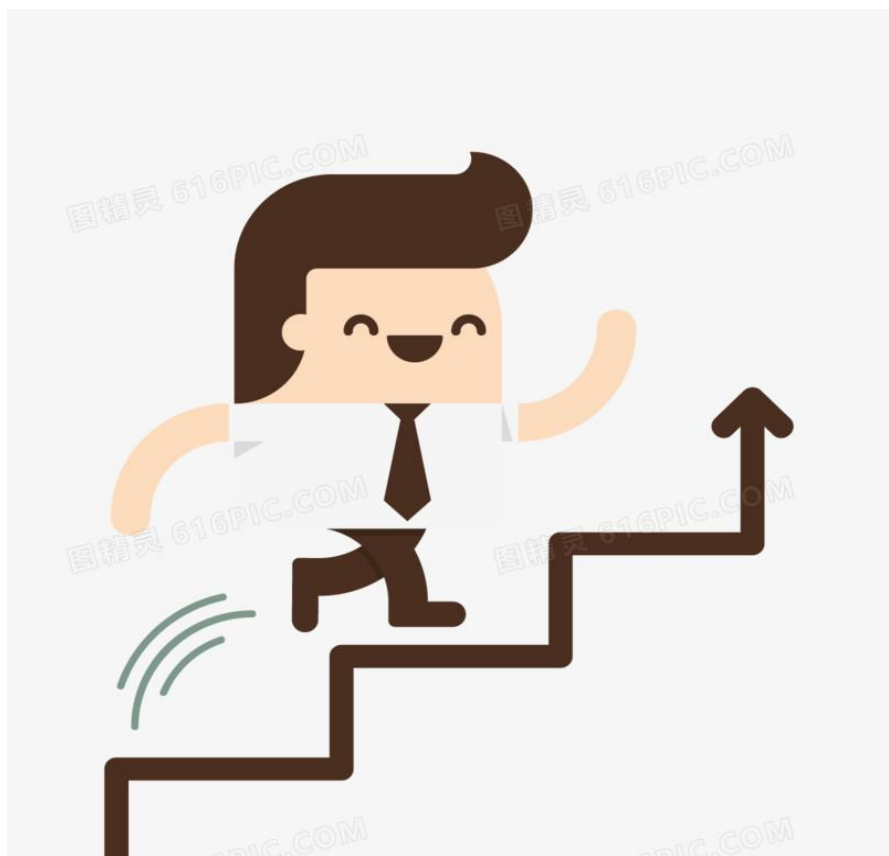
- 背銀



MLCC 需求非常強勁 將帶動未來成長

2018?!

MLCC



## 銀漿

1. 通過IC產品認證
2. 開發日本市場
3. 光電量產
4. 擴大現有市佔率

2025

## 銀漿

正式切入CHINA導線架IC封裝市場

2026年

## 銅漿

前進美國/日本被動元件廠

## 銅漿

1. 台灣/大陸第一品牌
2. 擴大MLCC市佔率

## 合金膏/TIM 1

1. 導入AI散熱及PCB高速傳輸應用
2. 開發應用於先進封裝材料

2026~

2025年

# Our Goal 2026-2027

@ 已於2026年 購入土地 建構新產能 以因應  
未來增加的訂單

@ EPS YoY 20-25%

@ 新應用領域

COWOS 先進封裝TIM1(Testing)

COPOS 先進封裝TGV/FOPLP(Testing)

ABF (Ready)

POWER封裝(Testing)

PCB 軟板高速傳輸(Ready)

ROBOT 機器人感測 (Ready)

TEST SOCKET 測試治具 (Testing)

@ 提升高毛利產品比重



- TIM1散熱材料應用於先進封裝提供新散熱解決方案材料。

現行市售TIM1使用材料：

	熱傳導	現況TIM1材料問題
矽膠	8 W/m. K	模量低但熱傳不足
石墨片	20 W/m. K	需增加接著劑黏接
銅片	80 W/m. K	熱傳高但模量大

**新TIM1材料技術指標**

熱傳導：> 80W/m. K

模量：< 3GPa

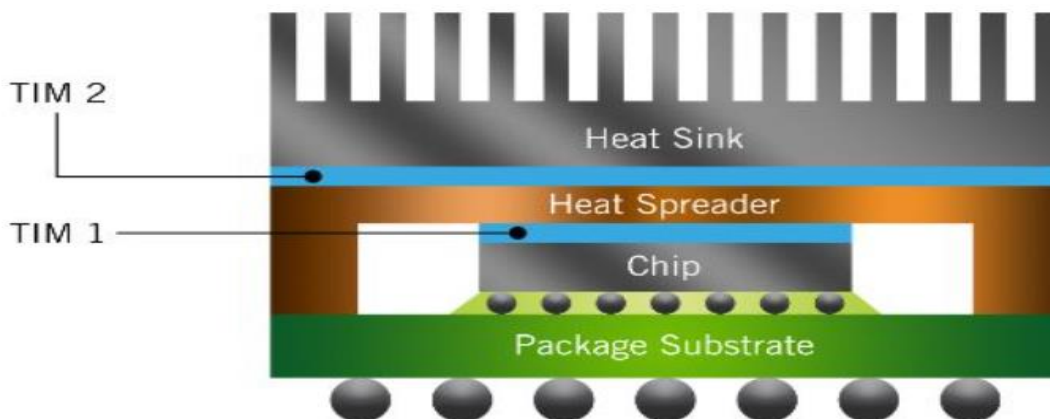
應用尺寸：65\*65mm



**Ample導入半燒結膠系統做改質：**

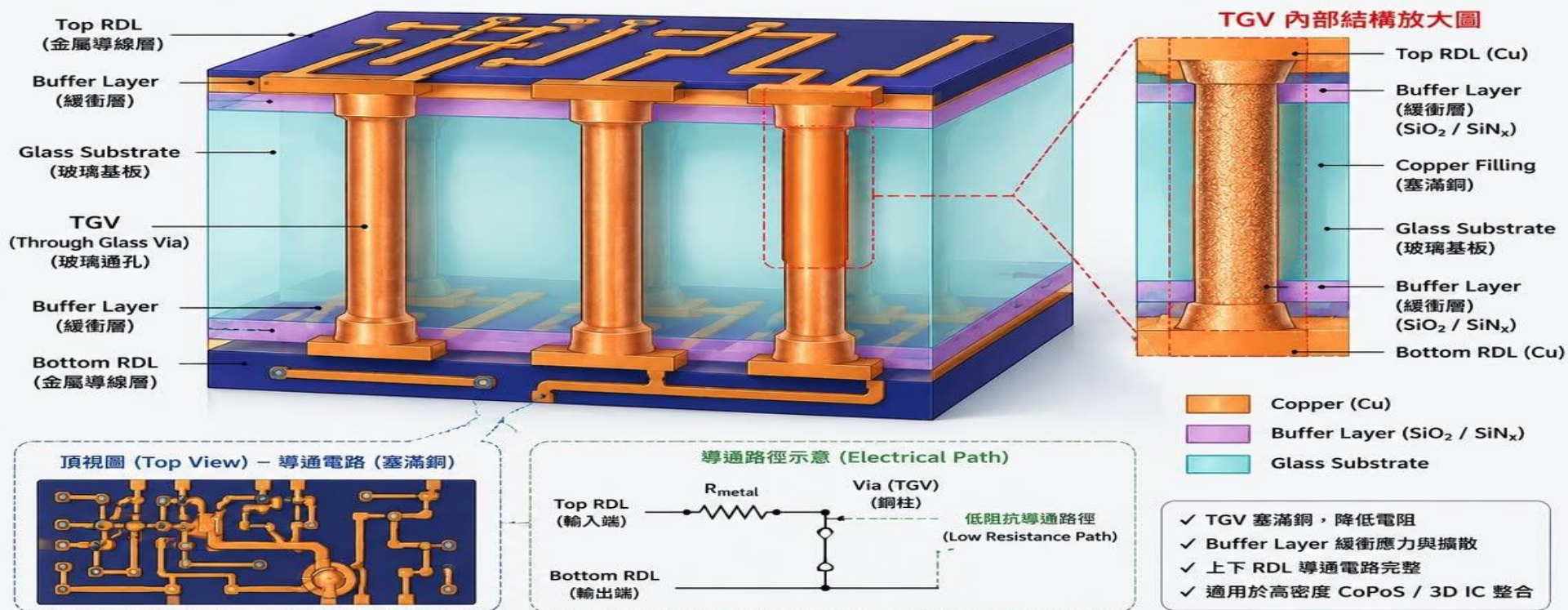
1. 高熱傳

2. 低模量



TGV (Through Glass Via) 技術就在玻璃基板上形成導電通道

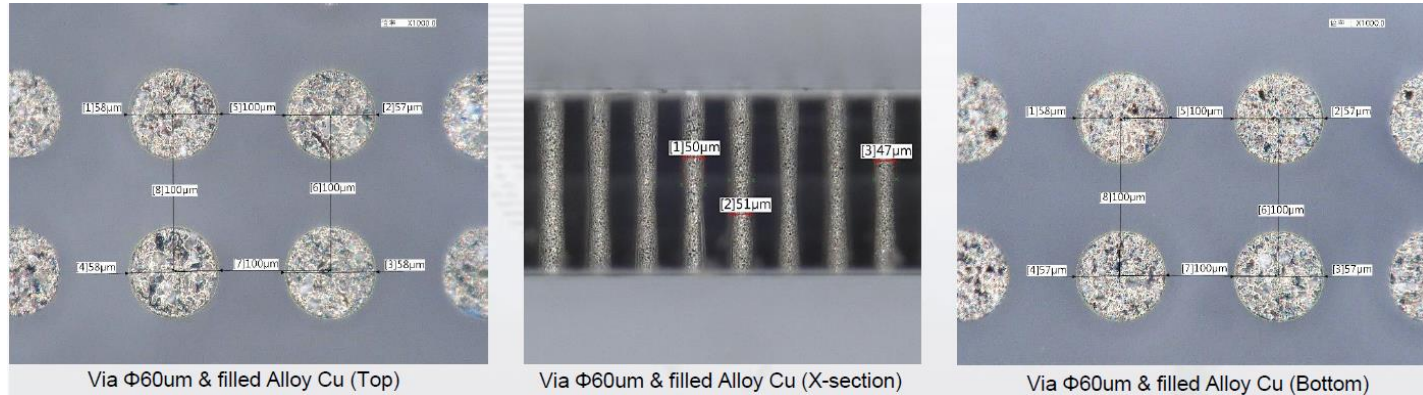
## TGV + 導通電路 (塞滿銅) 含 Buffer Layer 示意圖





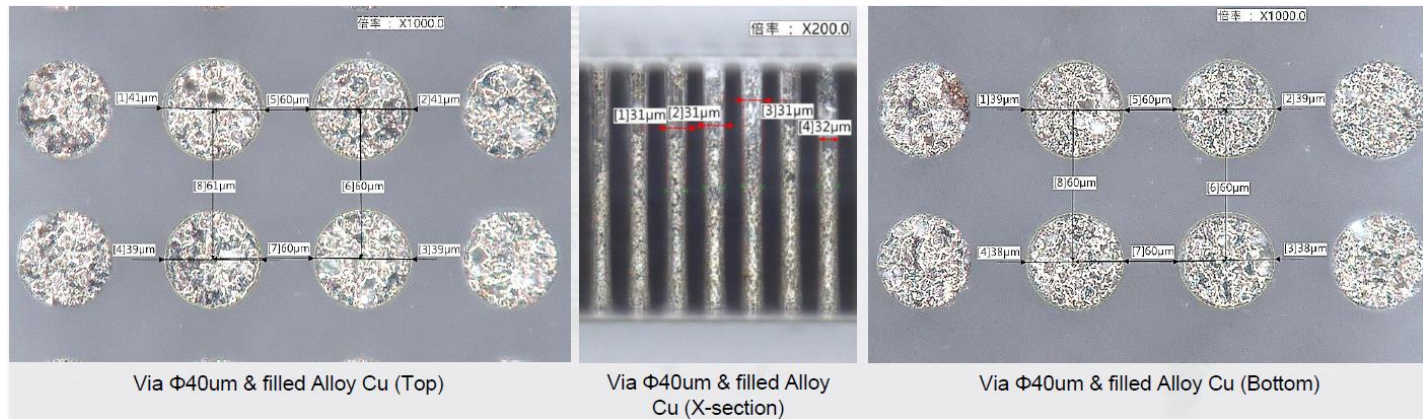
表面孔徑 : 60  $\mu\text{m}$   
 寬深比 : 1 : 8.3  
 (Aspect ratio)

➤ 填孔性、玻璃附著性 Pass



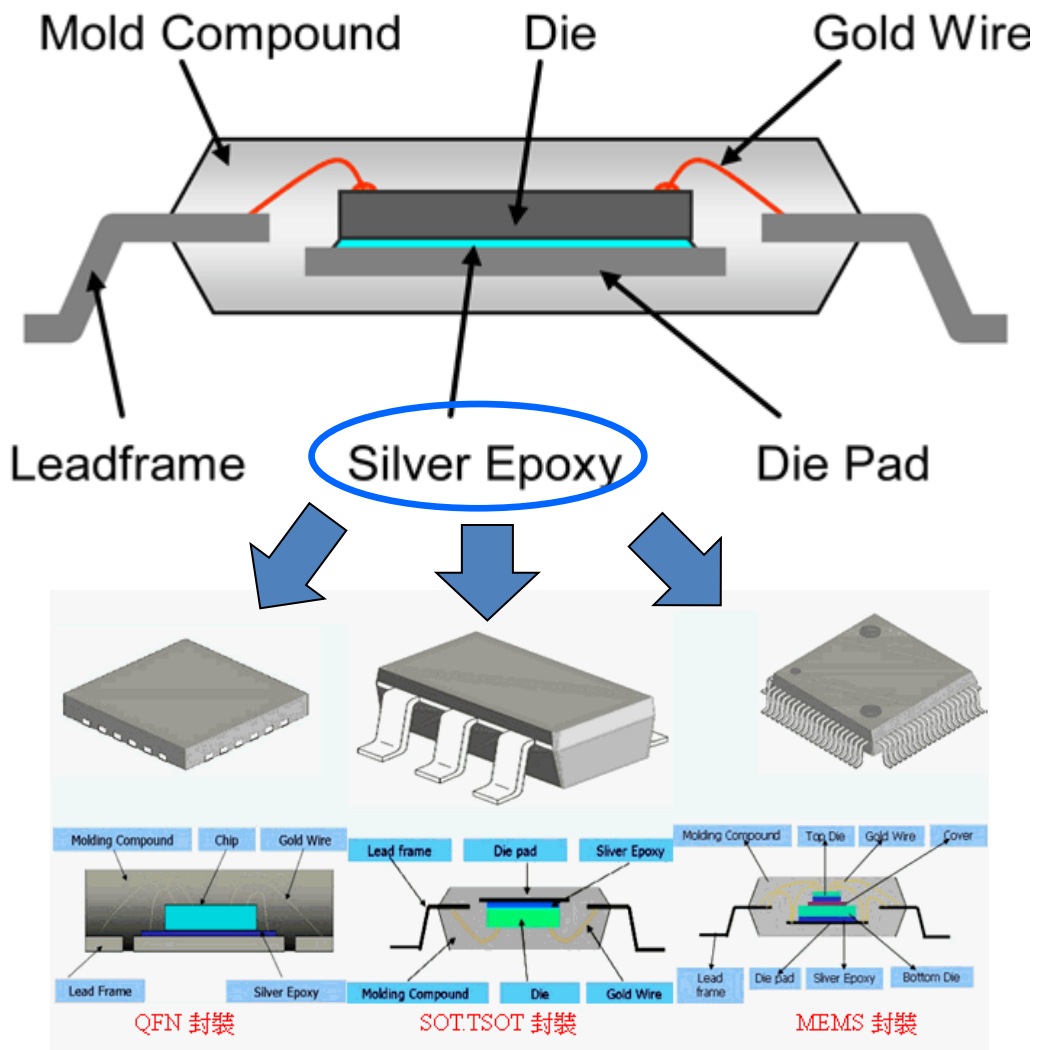
表面孔徑 : 40  $\mu\text{m}$   
 寬深比 : 1 : 12.5  
 (Aspect ratio)

➤ 填孔性、玻璃附著性 Pass



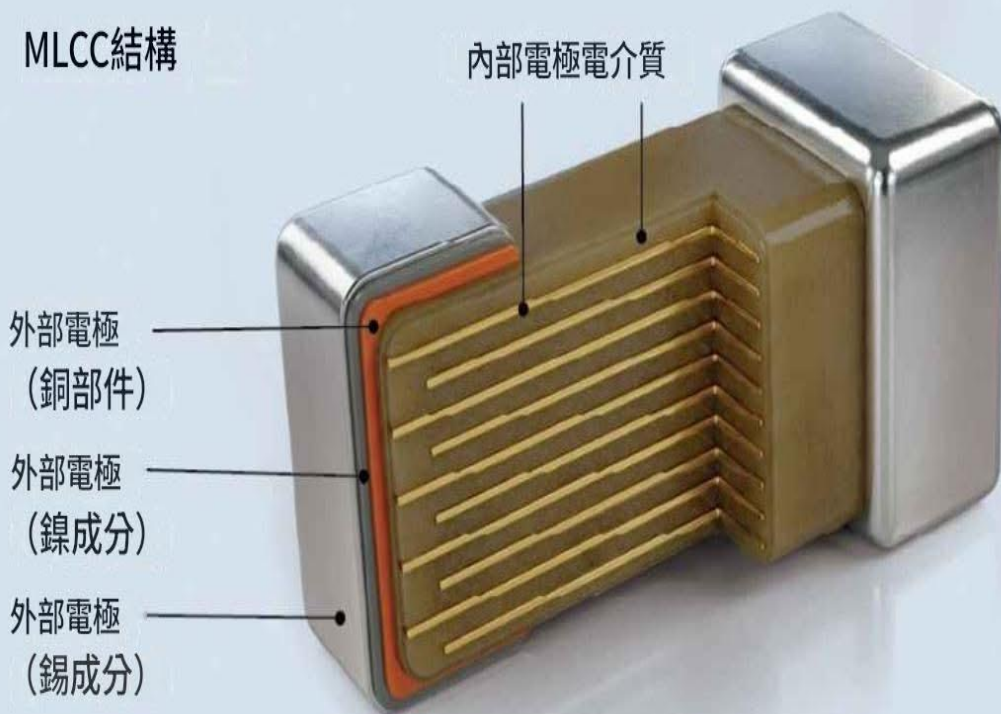


## 導線架 Die Bonding



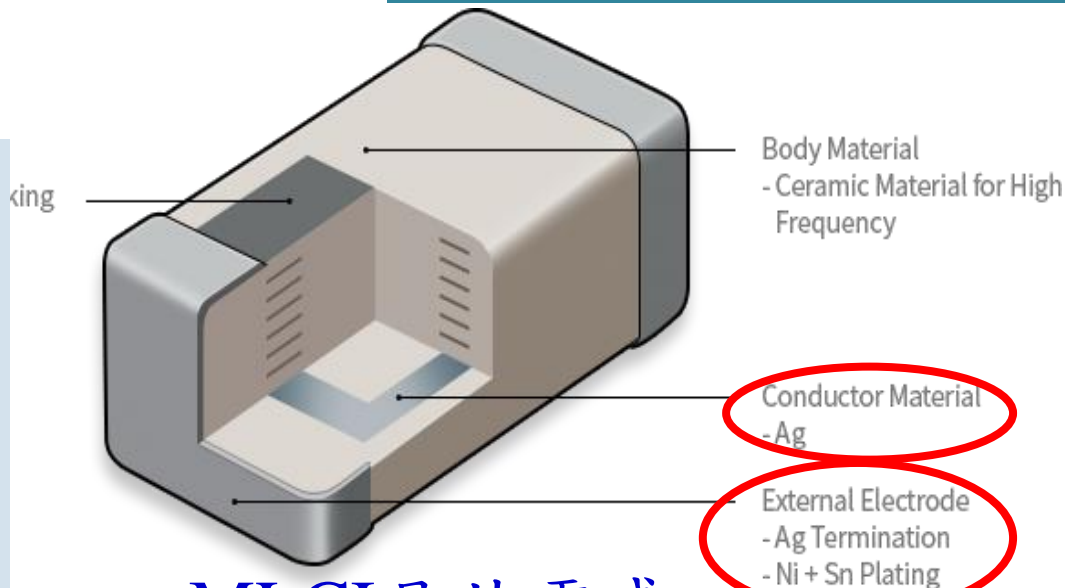
## MLCC電容

MLCC結構

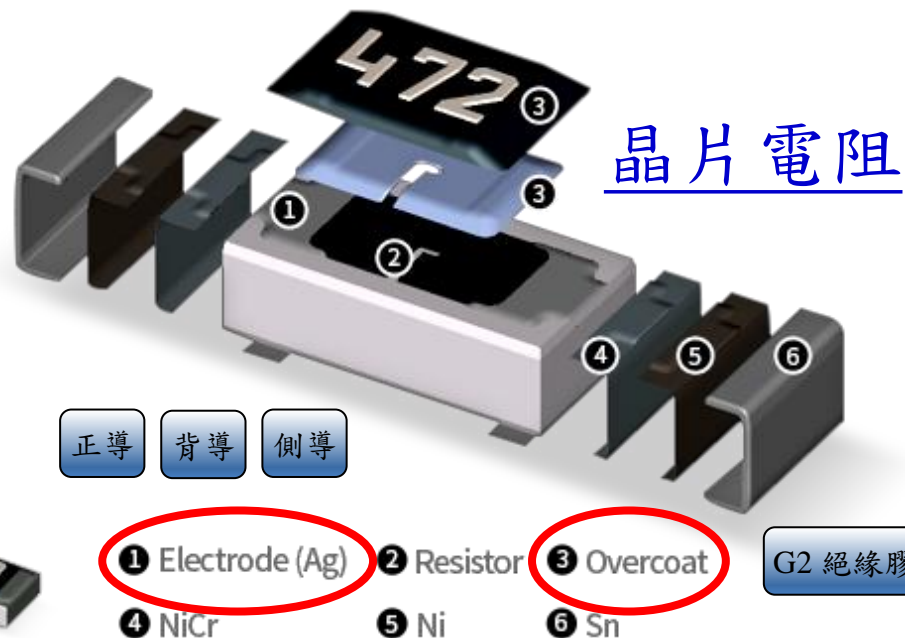


### 多層陶瓷電容器 (MLCC)

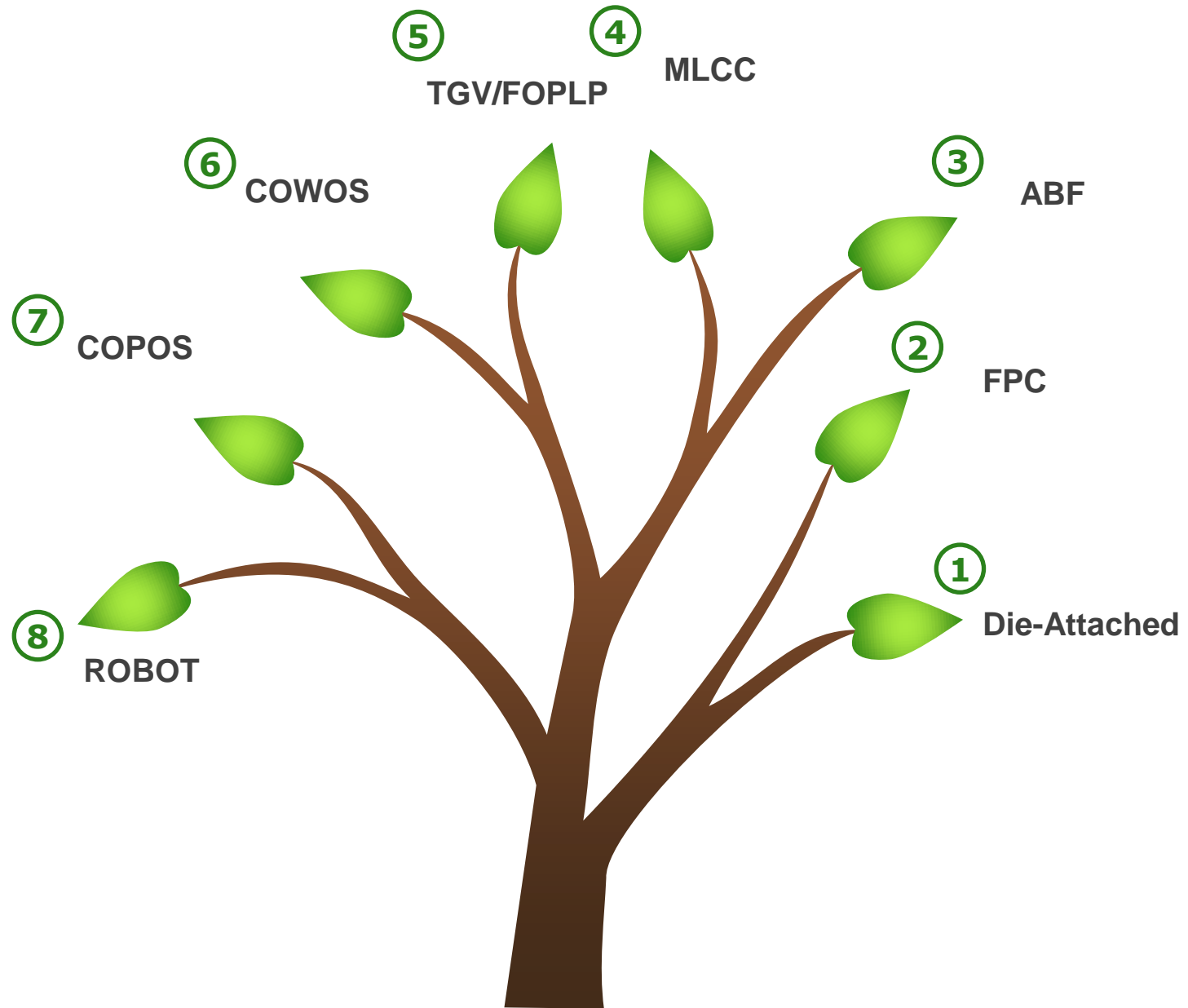
MLCC (多層陶瓷電容器) 是儲存電能並穩定地向圖形處理器 (GPU) 供電的關鍵組件，使半導體能夠平穩運作。它們還能消除電子產品中的訊號干擾，進而提高性能和穩定性。



## MLCI晶片電感



# 成長項目



# Q & A